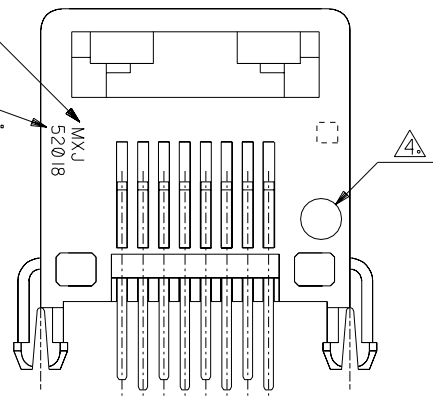
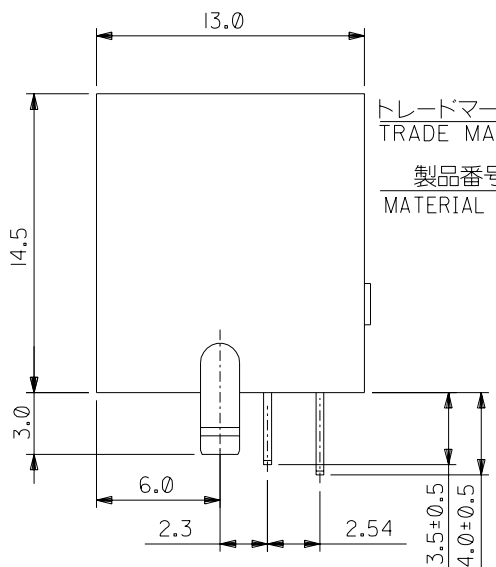
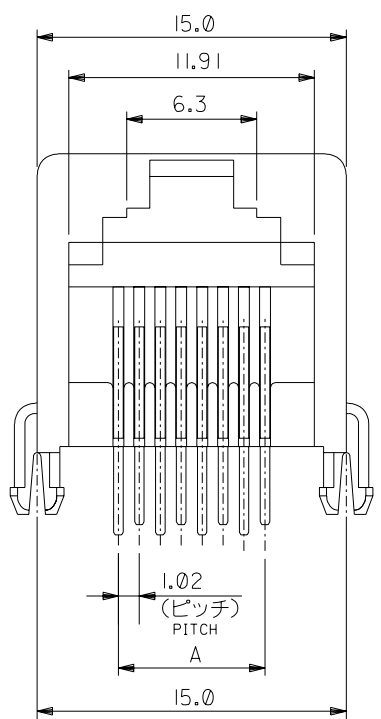


:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

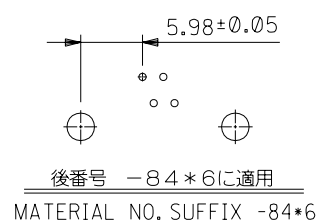
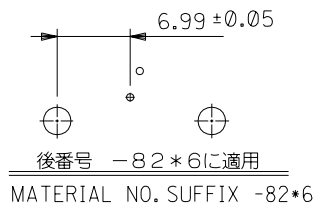
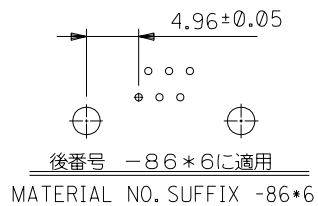
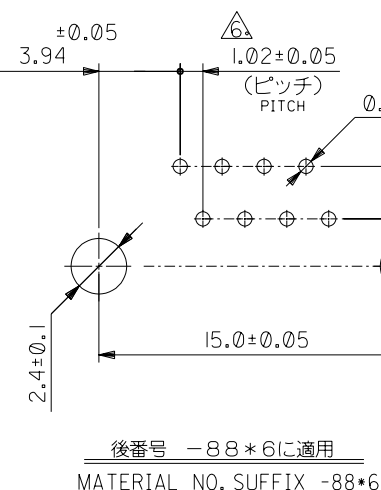
ENG. NO. SD-52018-001

EDP NO. #



注) NOTES

- 材質 MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0  
HSG. : POLYESTER G.F.15% UL94V-0  
ターミナル: リン青銅  
TERM. : PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING  
接点部 : 金メッキ、表参照  
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE  
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.  
SOLDER AREA : TIN 1.0µmMIN.  
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.  
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05  
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示  
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING  
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.  
YELLOW : 0.1µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.  
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.  
ORANGE : 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。  
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 公差非累積。  
NON-ACCUMULATIVE
- 本製品は 52018-8\*\*5 の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8\*\*5.



基板穴推奨寸法  
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
(ジャック取付け側)  
(JACK ASS'Y SIDE)

8	8	7.11	1.27	52018-8846
			0.76	-8836
			0.38	-8826
			0.1	-8816
				-8646
	6	5.08	1.27	-8646
	4	3.05	1.27	-8446
	2	1.02	1.27	52018-8246

52018-8**6	ポジション	極数	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 MATERIAL No.
MODEL NO.	POSITION	CIRCUITS			
				材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
				仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
				適用電線範囲 WIRE RANGE	#
				被覆外径 INS. RANGE	#
				DRAWN BY '04/04/28 M.NABEI	CHK'D BY '04/04/28 K.TOJO
				APP'D BY '04/04/28 M.SASAO	尺度 SCALE 4 - 1

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	+0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	+0.25
10未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

SD-52018-001.501

MXJ-8